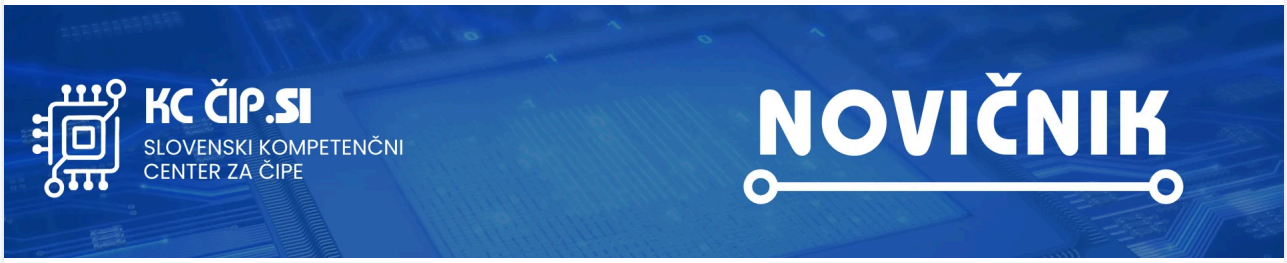
View in browser



Petek, 30. oktober 2026

Pozdravljeni,

razvoj evropskega in slovenskega polprevodniški ekosistem bolj in bolj pridobiva na hitrosti in širokemu spektru izdelkov in tehnologij. V tej izdaji izpostavljamo posodobljen pregled ključnih deležnikov, kompetenčnih centrov in podpornih mrež, ki vam lahko pomagajo pri iskanju partnerjev, storitev in razvojnih priložnosti ter s tem okrepite svoje možnosti novih poslovnih priložnosti.

Hkrati vas vabimo, da si rezervirate **27. in 28. januar 2027 za 5. konferenco SLO-Chip 2027** v Ljubljani, ki bo združila strokovnjake, podjetja, raziskovalce in študente s področij čipov, polprevodnikov, integrirane fotonike in kvantnih tehnologij. Poleg strokovnega programa bosta konferenco dopolnila poslovna sekcija in tradicionalno študentsko tekmovanje. Udeležba je brezplačna.

Želimo vam prijetno branje!



Dogodki KC Čip.si:

- Webinar: Chips Think Tank serija: **The European Chips Act 2.0: What's Next for Europe's Semiconductor Strategy?**
  24. november, 2026, 12:00 – 13:00, on-line
  Evropski akt o čipih (European Chips Act) je pomembno okrepil evropski polprevodniški ekosistem. Ker se industrija hitro razvija, se zdaj postavlja vprašanje, kako lahko Evropa nadgradi dosedanje izkušnje, ohrani konkurenčnost in dodatno utrdi svoj položaj v globalni vrednostni verigi polprevodnikov.
  V tej epizodi serije Chips Think Tank bo gost Marco Ceccarelli (DG CONNECT), s katerim bomo razpravljali o oceni trenutnega Akta o čipih ter

predlaganih spremembah v okviru Chips Act 2.0.
Registracija na dogodek tukaj.

- Opomnik za Webinar: **Webinar on Semiconductor Training Offers #2**
  27. oktober, 2026, 10:00 – 10:45, on-line
  Na dogodek se prijavite tukaj.
- Posodobljen katalog: **Posodobljen pregled evropskega polprevodniškega ekosistema**
  Na spletni strani KC Čip.si je na voljo posodobljen pregled ključnih deležnikov evropskega in slovenskega polprevodniškega ekosistema, ki vključuje:
  • seznam evropskih kompetenčnih centrov (Chips Competence Centres),
  • pregled slovenskih deležnikov polprevodniškega ekosistema,
  • povezave do evropskih združenj, mrež in podpornih iniciativ,
  Povezava: https://cc-chip.si/offer/#trainings
  Pregled je javno dostopen in namenjen startupom, podjetjem, raziskovalcem, študentom in drugim organizacijam, ki želijo vzpostaviti nove povezave, poiskati podporo za razvoj ali bolje razumeti evropski polprevodniški ekosistem.
- Napoved konference: **5th Slovenian conference on chips and semiconductors SLO-Chip 2027**
  27. - 28. januar, 2027, Ljubljana
  5. konferenca SLO-Chip 2027 bo vsebovala bogat in raznolik program s področij čipov, polprevodniških tehnologij, integrirane fotonike in kvantnih tehnologij. Konferenca bo nadgrajena s posebno izvedbo poslovnoe sekcije kot tudi s tradicionalnim študentskim tekmovanjem.
  Udeležba na konferenci je brezplačna.
  Več informacij bo na voljo na strani konference SLO-Chip 2027.



SLO-Chip 2027

Rezervirajte si 27. in 28. januar 2027 za udeležbo na 5. konferenci SLO-Chip 2027.

Vljudno vabljeni!

Drugi dogodki:

- Konferenca: **AI and the Great Semiconductor Divide: Strengthening Europe's Competitiveness**
  16 .- 17. november, 2026, Malta
  3. izvedba konference GSCM 2026 bo naslovila ključna vprašanja prihodnosti evropske polprevodniške industrije, od vpliva umetne inteligence do tehnološke suverenosti in razvoja celotne vrednostne verige. Na konferenci se bodo srečali in izmenjali poglede vodilni predstavniki industrije, raziskav, start-upi in oblikovalci politik z namenom krepitve evropske konkurenčnosti.
  Registracija na konferenco tukaj.
- Delavnica: **2026 TSMC Europe Open Innovation Platform Ecosystem Workshop**

24. november, 2026, 8:30 – 18:00, Munchen, Nemčija
Forum bo združil vodilne deležnike s področja načrtovanja in proizvodnje čipov, kjer se bodo ideje vodilnih tehnoloških pionirjev razvile v realnost.. Na dogodku bo sodeloval tudi imec IC-Link, ki bo predstavil možnosti sodelovanja na področju ASIC-ov, fotoničnih integriranih vezij (PIC) in naprednega pakiranja. Forum predstavlja pomembno priložnost za mreženje, iskanje partnerjev in vpogled v najnovejše trende polprevodniške industrije.
Registracijo na dogodek tukaj.

Novice KC Čip.si:

- **Izobraževanja:** Vabimo vas, da si poleg ponudbe KC Čip.si ogledate možnosti pridobivanja novih znanj in kompetence drugih kompetenčnih centrov pod okriljem aCCCess.

Katalog izobraževanj KC čip.si

Katalog izobraževanj aCCCess

Razpisi:

- Zadnji poziv za razpis: **International collaboration EU and Japan on semiconductors**
  Ta skupni razpis se osredotoča na razvoj ekosistema čipletov za umetno inteligenco (AI) in naprednih procesnih tehnologij za proizvodne vozlišča pod 2 nm, pri čemer poteka sodelovanje v partnerstvu z japonskimi konzorciji.
  Koda področja: DIGITAL-JU-Chips-2026-SG-JAPAN
  Rok za oddajo prijave: 08. december, 2026

- Razpis: **INFRACHIP Open Call to Free Access to State-of-the-Art Technologies**
  INFRACHIP ponuja raziskovalcem in inovatorjem brezplačen dostop do infrastrukture in tehnologij na desetih evropskih lokacijah za razvoj polprevodniških rešitev na zgodnjih in srednjih stopnjah tehnološke zrelosti.
  Prijava in pogoje sodelovanja tukaj.

- Razpis: **XECS CALL 6 IN THE FIELD OF ELECTRONIC COMPONENTS & SYSTEMS AND ITS APPLICATIONS**
  Xecs je program grozda Eureka, namenjen pospeševanju trajnostnih inovacij na področju elektronskih komponent in sistemov (ECS). S povezovanjem podjetij, raziskovalnih organizacij in akademske sfere spodbuja mednarodne razvojno-raziskovalne projekte z velikim gospodarskim in družbenim vplivom.
  Kdo lahko sodeluje? mala in srednja podjetja, velika podjetja, raziskovalne in tehnološke organizacije (RTO) in univerze in raziskovalne ustanove.
  Ključna področja: celotna vrednostna veriga ECS, skladno z raziskovalno-inovacijsko agendo združenj AENEAS, EPoSS in INSIDE.
  Pomembni datumi:
  Rok za oddajo Project Outline (PO): 21. januar, 2027
  Rok za oddajo Full Project Proposal (FPP): 15. april, 2027
  Ob razpisu bo 6. in 7. oktobra 2026 na Dunaju potekal tudi Xecs Matchmaking Event, namenjen povezovanju potencialnih projektnih

partnerjev.
Več informacije najdete na tem mestu tukaj.

Novice:

- **Poročilo EPO: Europe's technology transfer landscape: The current state, challenges and avenues for development of technology transfer offices**
  Študija ugotavlja, da ima Evropa izjemno raziskovalno bazo, vendar mora učinkoviteje pretvarjati znanstvene dosežke v inovacije, podjetja in gospodarsko vrednost. Ključno vlogo pri tem imajo pisarne za prenos tehnologij (TTO), ki povezujejo raziskovalce, industrijo in vlagatelje, pri čemer ostajajo glavni izzivi financiranje, komercializacija tehnologij ter dostop do mednarodnih trgov.

- **Laser annealing integrates optical isolators directly onto silicon photonics chips without overheating**
  Raziskovalci so razvili metodo za integracijo optičnih izolatorjev neposredno na silicijeve fotonske čipe z lokalnim laserskim žarjenjem. Metoda posredno pomeni pomemben korak za silicijevo fotoniko, podatkovne centre in AI sisteme.

Nekateri deli vsebine so bili oblikovani s pomočjo umetne inteligence (UI) in so bili naknadno pregledani ter dopolnjeni s strani avtorja.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,

ekipa KC Čip.si

KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI CENTER ZA ČIPE

Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25,Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran: https://cc-chip.si/







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljeni na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

Odjava

SENT BY mailerlite